

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表明概不就本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



PacMOS Technologies Holdings Limited **(弘茂科技控股有限公司)***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1010)

有關 持續關連交易 之公佈

於二零零七年二月二日，上海新茂與台灣新茂訂立協議，據此，台灣新茂將根據及按照協議之條款，向上海新茂提供服務，由二零零七年一月一日起至二零零九年十二月三十一日止為期三(3)年。

台灣新茂由本公司及台灣茂矽分別持有約55%及約24.20%。台灣茂矽為本公司之主要股東及關連人士，因此，上海新茂與台灣新茂訂立協議(包括其項下擬進行之交易)構成本公司之持續關連交易。

預期協議之每年總購買價不會超過10,000,000港元，而各項有關百分比率(定義見上市規則)將低於25%。根據上市規則第14A.34(2)條，協議項下之交易僅須遵守上市規則第14A.45至14A.47條所載申報及公佈之規定，並獲豁免遵守本公司獨立股東批准之規定。上述持續關連交易之詳情將根據上市規則第14A.45條之規定載於本公司下一份年報及賬目。

協議之條款

- 日期： 二零零七年二月二日
- 訂約方： (1) 上海新茂，本公司之全資附屬公司
(2) 台灣新茂，本公司擁有約55%之附屬公司
- 年期： 由二零零七年一月一日起至二零零九年十二月三十一日止為期三(3)年，惟(其中包括)任何一方有權透過向對方發出三個月事先書面通知終止協議。
- 台灣新茂將向上海新茂提供之服務： 透過訂立購買合約委託獨立第三者根據上海新茂所提供之有關規格及功能提供掩膜、晶圓、測試及／或封裝，為上海新茂採購及購買掩膜、晶圓、測試及／或封裝。

費用： 台灣新茂不得就服務向上海新茂收取任何服務費，惟上海新茂須負責支付購買價，並須向台灣新茂償付於根據本協議及所有購買合約履行其職責時適當產生之一切合理開支及稅項(如有)。

最高年度總額： 所有購買合約截至二零零七年十二月三十一日、二零零八年十二月三十一日及二零零九年十二月三十一日止三(3)個年度各年之最高年度總額分別不得超過7,000,000港元、8,500,000港元及9,800,000港元。上述最高年度總額乃按過往購買成本數據、集成電路產品市場之預計增長及上海新茂之預算預測而制定。上海新茂截至二零零六年九月三十日止九個月與獨立第三者產生之總購買成本約為2,400,000港元，而截至二零零六年十二月三十一日止三個月與台灣新茂產生之總購買成本則約為190,000港元。

為免疑問，台灣新茂在履行其於本協議及所有購買合約項下之責任而適當產生之一切合理開支及稅項，將於計算上述之最高年度總額時計算在內。台灣新茂於截至二零零六年十二月三十一日止三個月所產生之有關開支及稅項金額約為12,000港元。估計將產生之有關開支及稅項金額約為購買價之6%。

根據協議，上海新茂可(在台灣新茂同意下)(惟並無責任)按非獨家基準於年期內不時委聘台灣新茂向上海新茂提供服務。協議須待於二零零七年二月十五日或其訂約方可能協定之有關其他日期或之前，自一切有關政府、監管及其他機構(包括聯交所)就本協議項下擬進行之交易取得一切所需同意、批准及授權後，方可作實。

本集團之資料及訂立協議之理由

本集團之主要業務為集成電路產品設計、銷售及分銷以及其他投資。

上海新茂主要從事於中華人民共和國為市場進行集成電路設計及產品開發。

台灣新茂主要從事批發電子原料及零件、提供工業及商業服務(包括研究及開發電子原料及零件)以及產品設計。

由於上海新茂及台灣新茂均從事集成電路設計及批發電子零件，並需要獨立第三者供應掩膜、晶圓、測試及／或封裝，故董事會認為，倘上海新茂及台灣新茂可集中其購貨，則可議定較有利之供應條款及被視為較尊貴之客戶。

董事(包括獨立非執行董事)認為，協議及其項下擬進行之交易乃按公平原則訂立，而從上海新茂之角度，乃按一般或比一般為佳之商業條款訂立。董事(包括獨立非執行董事)認為，協議及其項下擬進行之交易之條款乃屬公平合理，並符合本集團及本公司股東之整體利益。

協議訂約方與本公司之關係

台灣新茂為本公司及台灣茂矽分別持有已發行股本約55%及約24.20%之合營公司。餘下約20.8%股權由台灣茂矽及其附屬公司之董事及／或高級行政人員擁有約5.71%，及就董事所知、所得資料及所信，由獨立第三者擁有約15.09%。台灣茂矽為本公司之主要股東及關連人士，因此，上海新茂與台灣新茂訂立協議(包括其項下擬進行之交易)構成本公司之持續關連交易。

預期協議之每年總購買價不會超過10,000,000港元，而各項有關百分比率（定義見上市規則）將低於25%。根據上市規則第14A.34(2)條，協議項下之交易僅須遵守上市規則第14A.45至14A.47條所載申報及公佈之規定，並獲豁免遵守本公司獨立股東批准之規定。上述持續關連交易之詳情將根據上市規則第14A.45條之規定載於本公司下一份年報及賬目。

於本公佈日期，執行董事為葉稚雄先生及陳澤元先生，而獨立非執行董事則為黃之強先生、鄭鶴鳴先生及馬桂園先生。

釋義

本公佈所用詞語及詞彙具有下列涵義：

「協議」	指	台灣新茂與上海新茂於二零零七年二月二日就台灣新茂向上海新茂提供服務而訂立之協議；
「董事會」	指	董事會；
「本公司」	指	弘茂科技控股有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司，其股份在聯交所上市；
「關連人士」	指	具上市規則所賦予之涵義；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「獨立第三者」	指	獨立於本集團任何成員公司、本公司或其附屬公司董事、高級行政人員、控股股東及主要股東以及彼等各自之聯繫人士（定義見上市規則）之人士或公司；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「掩膜」	指	具有透明或不透明範圍圖案之玻璃板，用作壓製底板以製造集成電路。「掩膜」一般亦稱為「光罩」；
「台灣茂矽」	指	台灣茂矽電子股份有限公司，本公司之主要股東（定義見上市規則）；
「封裝」	指	焊接於金屬架並以環氧化合物封邊之集成電路，以鑲嵌於印刷電路板上。金屬架及封邊化合物稱為「封裝」；
「購買合約」	指	台灣新茂（應上海新茂之要求）或上海新茂於年期內就供應掩膜、晶圓、測試及／或封裝與獨立第三者訂立之合約、協議或交易；
「購買價」	指	上海新茂根據協議批准就購買合約應付之金額；

「服務」	指	根據上海新茂所提供之規格及功能，為上海新茂採購及購買掩膜、晶圓、測試及／或封裝；
「上海新茂」	指	上海新茂半導體有限公司，根據中華人民共和國法例成立之公司，並為本公司之全資附屬公司；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「台灣新茂」	指	新茂國際科技股份有限公司，根據台灣法例註冊成立之公司，並為本公司擁有約55%之附屬公司；
「測試」	指	以晶圓或封裝形式測試集成電路以保證經加工之集成電路符合規格。測試一般由已安裝規格界定測試程式之專門測試電腦進行；
「年期」	指	由二零零七年一月一日起至二零零九年十二月三十一日止三(3)年期間；
「晶圓」	指	薄、圓而平之矽片，經已由工廠利用掩膜在矽底板上印刷集成電路進行加工。每塊晶圓含有幾千塊功能相同之集成電路；
「港元」	指	港元；及
「%」	指	百分比

承董事會命
弘茂科技控股有限公司
 主席
葉稚雄

二零零七年二月二日，香港

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。